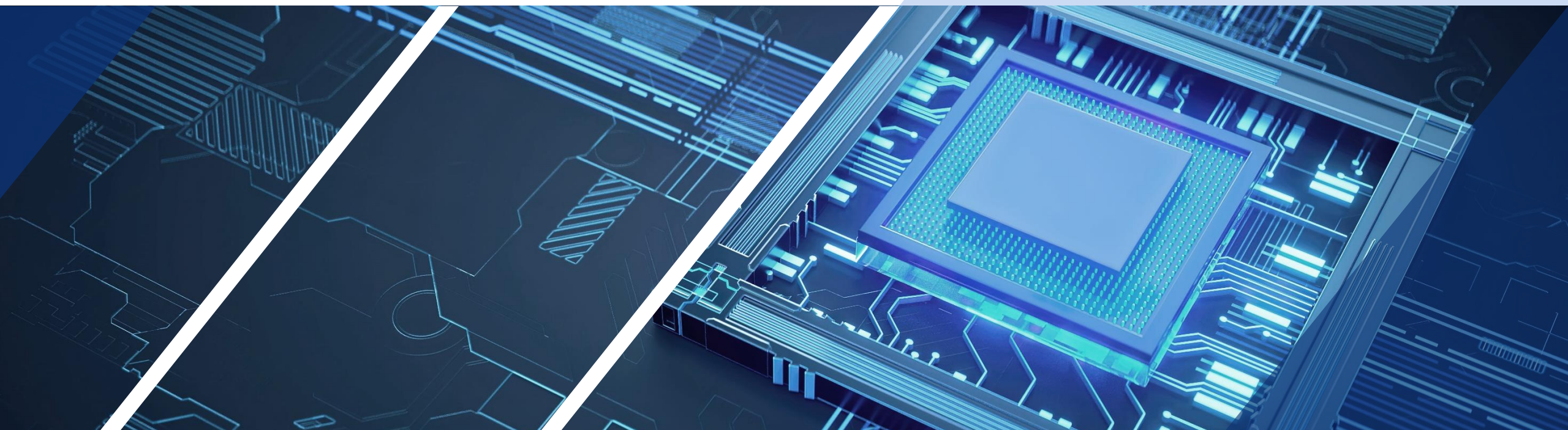


2024년 한경국립대학교

반도체 인력양성 부트캠프 사업 설명회

- 2024. 9. 3.(화) -



CONTENTS

- 1 사업 개요
- 2 사업 목표
- 3 추진 계획 및 연차별 목표
- 4 참여 기업 및 학과
- 5 교육과정
- 6 이수자 관리 및 취업 연계
- 7 참여기업 활동 계획
- 8 관련 서류 양식

1 사업 개요

☑ 사업 목적

- 반도체 소재·부품/장비(소부장)·공정 분야의 산업경쟁력 강화를 위한 산업 밀착형 실무인력 양성 및 공급
- 반도체 소재·부품/장비·공정 분야 소단위 전공과정 운영

☑ 모집 및 사업내용

- 초급: 모든 학과 3학년 재학생 50명 모집
- 중급: 4학년 졸업예정자(25년 2월 졸업예정자) 100명 모집
- 중급과정 참여자격: 전자전기공학부, ICT로봇기계공학부, 화학공학전공 재학생
 - ※ AI반도체융합학부는 2025학년도 1학기부터 참여 가능
- 중급 과정 이수자에게는 이수증 수여, 장학금* 지급(최대 150만원)
 - * 취업연계지원 장학금: 생활비 지원성 100만원 + 등록금 지원성(~50만원, 차등지급)
 - ※ 초급 과정 이수자는 차년도 중급 과정 신청 시 우선선발

2 사업 목표

1



최종 목표

- 반도체 소재·부품/장비(소부장)·공정 분야 산업경쟁력 강화를 위한 산업 밀착형 실무인력 양성 및 공급

2



세부 목표

- 산업체 수요 기반의 반도체 소부장/공정 산업 실무인력 교육과정 개발·운영
- 산업의료원(애로기술), 산업체 현장실습 운영 등 산학협력 체계 구축·운영
- 반도체 소부장/공정 실습/설계 교육을 위한 교육 인프라 구축·운영

3



2024년 목표

- 산업수요기반 반도체 소부장/공정 실무인력 전공트랙 교육과정 개발·운영
- 반도체 소부장 및 반도체 교육 인프라 구축, 산업체 애로기술 해결, 산업체 현장실습 체계 구축·운영

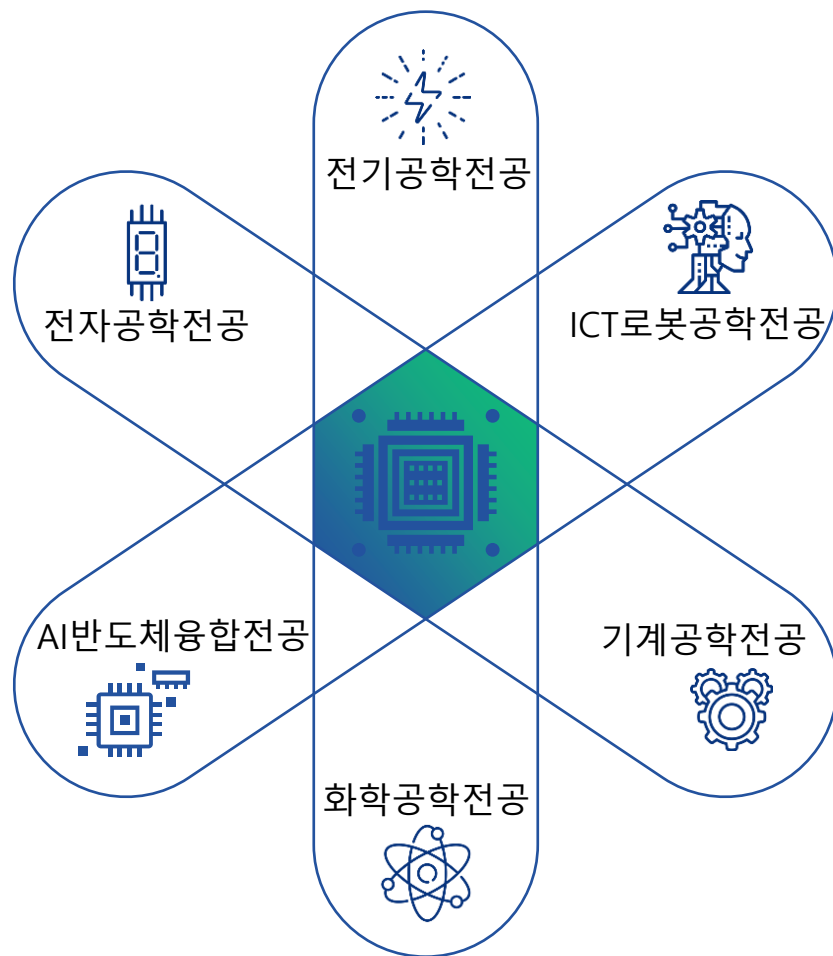
3 추진 계획 및 연차별 목표

	2024 2025 2026 2027 2028		
	도입기	안정기	성숙기
학 생	참여학과 중심운영	참여학생 범위 확대 (비공학계열, 타 대학교 학생)	참여학생 수 증대
강 사	산업 현장 전문가를 포함하는 전문교육인재 POOL 구축	산업 현장 전문가를 포함하는 전문교육인재 POOL 확대	산업현장 전문가 POOL 네트워크 시스템 구축
산 업 체	교육과정 공동개발 및 운영 산업의료원 참여, 취업연계	교육과정 공동개발 및 운영 산업의료원 참여, 취업연계	교육과정 공동개발 및 운영 산업의료원 참여, 취업연계
교육과정	안성 및 평택캠퍼스 내 마이크로디그리 과정 개설 운영	교육 환류 시스템을 이용한 교육과정 개선 및 운영	기업 밀착형 교육과정 구성 및 운영
교육환경	실험실습장비 도입 및 운영 실험실습실 환경개선	반도체 실습 관련 S/W 확충 실험 실습 장비 확충	반도체 실습 장비 등 인프라 확충

4 참여기업 및 학과

반도체 부트캠프 사업에 개설되는 직무 및 참여 학과

직무명	참여 학과명		교원 수
	학과명(캠퍼스)	졸업예정 인원 (2025년 예정)	
반도체 소재 반도체 부품/장비 반도체 공정	전자공학전공(안성)	87명	27명
	전기공학전공(안성)	56명	
	ICT로봇공학전공(안성)	73명	17명
	기계공학전공(안성)	37명	
	화학공학전공(안성)	78명	12명
	AI반도체융합전공(평택)	'23년 개설('27년에 졸업)	5명
합 계		331명	



2024학년도 2학기 교육과정

연차	등급	형태	소단위 전공과정 명칭			비고
			반도체 소재	반도체 부품/장비	반도체 공정	
1차년도	초급	교과형	전자기학(반도체 공정)			기초
		몰입형	반도체입문(비이공계) / 반도체공학개론(이공계)			
	중급	교과형	배터리 공학	지역신재생에너지	융합반도체공학	소단위 전공과정
				제어시스템		
				로봇시스템		
				지능형 자율이동체공학	반도체공 정공학	
		몰입형	반도체및기기분석	공정이상진단및해석	반도체종 합 공정공학	
				플라즈마 전원장치설계		
			첨단소재 디자인 및 전산응용	반도체장비용 UPS설계		
				반도체패키징		

교육이수자 관련 DB 구축 및
<이수자 관리 통합 플랫폼>을 활용한 지속적 관리

- ☒ 이수자 교육내역 DB화 ☒ 취업 지원을 위한 기초정보 DB화
- ☒ 취업관련 컨설팅 및 진로지도 참여 결과 DB화
- ☒ 참여기업 구인정보 DB화

이수자	소속	전공	이수 커리큘럼 내역	결과
A	한경국립대학교	전기공학전공	(중급) 반도체 장비 엔지니어	수료
B	타교 학생	○○학과	...	...

교육프로그램 이수자 지속적 관리 프로그램

구 분	프로그램 내용
주기적 상담 관리 시스템 구축	· 취업희망 요구조사 분석 시스템 구축 · E-Mail, SNS 등을 통한 주기적 상담관리 시스템 구축 · 상담 및 취업희망 요구 조사를 통해 교육생에 맞는 분야로 취업 연계 · 교육내역, 능력평가, 기초정보 등 DB의 지속적 관리 · 취업컨설팅 전문가를 초빙하여 취업상담(이력서, 자기소개서, 포트폴리오)
이수자에 적합한 진로지도 및 취업지도	· 전문교육 이수교과와 관련된 협약기업 취업업체 선정 · 취업업체 선정 시 교육생 의사 반영(선 면접 및 기업탐방 기회 제공) · 참여(취업)기업 근무에 관한 제반 교육 · 외부전문가를 투입하는 자격증 취득프로그램 운영 · 산업 및 주요기술 동향, 재직자와의 만남 등 취업약정자 대상 진로특강
취업자에 적합한 추후 지도	· 취업생 잔존을 위한 프로그램 개발 운영 · 지속적인 현장 추수지도 실시 및 현장상담 · 경력관리체계(Career portfolio management system) 시스템 운영 · 현장에 관한 현장관리 통계자료 작성 · 기능사 ⇨ 산업기사 ⇨ 기사연계 자격증 업그레이드 지원 관리

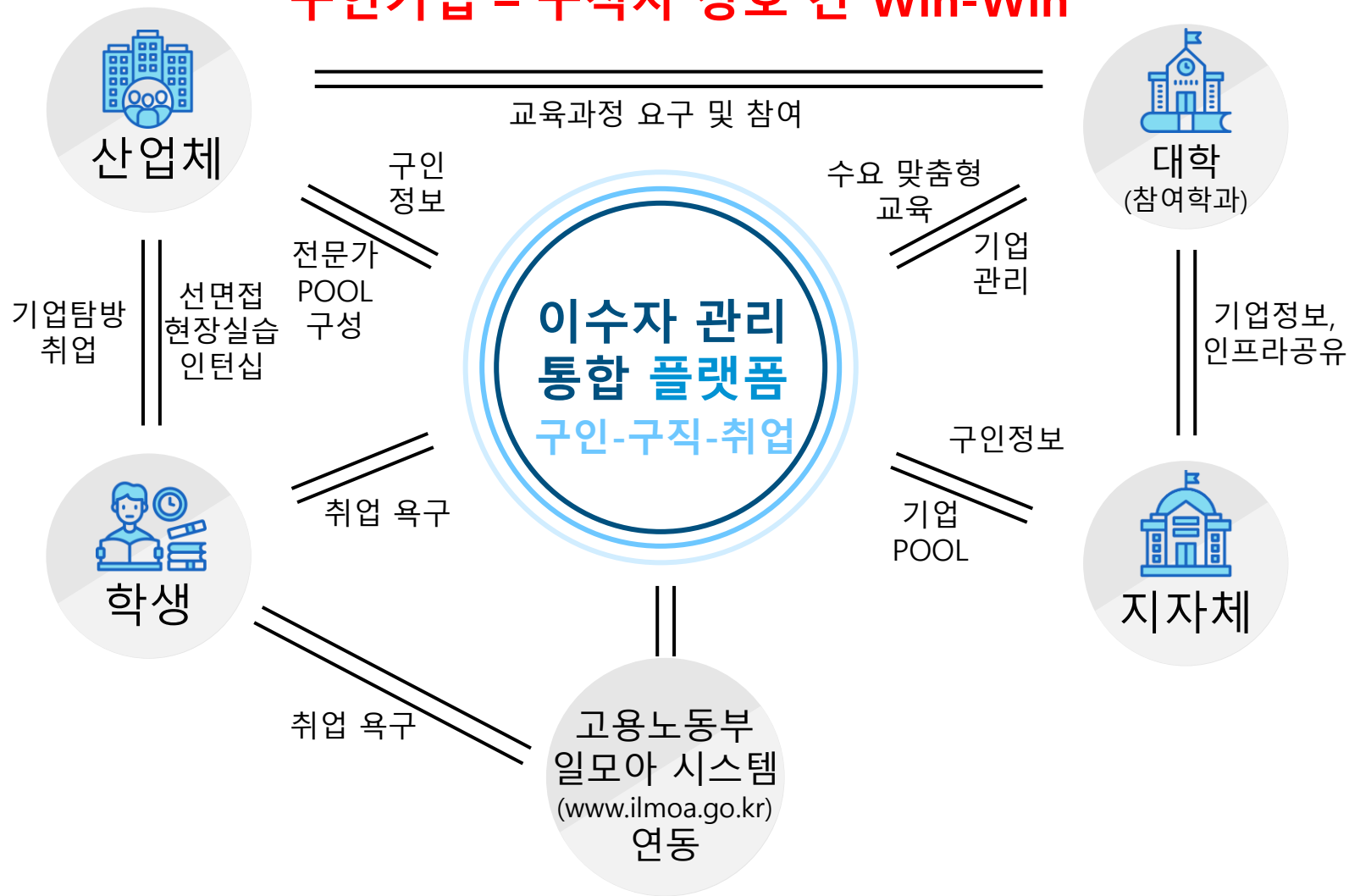
취업박람회 개최



<이수자 관리 통합플랫폼 구축>

참여기업 현황 및 구인정보 DB, 학생 정보(교육과정 참여정보 및 취업 수요 등) DB, 지자체 일자리 정책부서의 채용 수요, 정부 지원 일자리사업 정보 제공과 관리를 위한 **일모아시스템(www.ilmoa.go.kr)** 등과 **연계하여 반도체 분야 취업 지원**

구인기업 - 구직자 상호 간 Win-Win



7 참여기업 활동 계획

- ▶ 대학·기업·학생 간 공생체계 구축 ↔ 구인·구직자 간 사전 미팅 및 기업탐방 ↔ Win-Win 체계 구축
- ▶ 산업 및 학생 간 교집합(특강, 견학 및 PBL 등) 확대 → 실무능력이 배양된 맞춤형 인력 양성 및 채용 연계
- ▶ 성과확산 발표회(채용박람회) 등 확대, 참여기업 간 공유체제 구축을 통해 기술 및 정보교류 장 마련
- ▶ 기업 인력수요와 학생 취업요구 분석 → 선면접 및 기업탐방 등을 통해 쌍방이 원하는 취업 매칭 → 장기근무 유도

구분	참여활동	참여방안
상호교류	교육과정 공동 개발	· 대학, 기업이 참여하는 수요 맞춤형 교육과정 개발
	교육과정 공동 운영 (산업의료원 등 협력)	· 산학 임직원이 교육과정 개발·운영·평가 등에 공동 참여 → 애로기술을 산학과제로 발굴, 공동 해소 지원
	성과분석 및 공유	· 지·산·학이 참여하는 성과발표회 연 1회 개최 · 기업 인사담당자가 참여하는 자체평가위원회 → 만족도 조사결과 공유 및 차년도 사업 피드백
대학지원	인력양성 및 공급	· 산업수요에 따른 직무와 실무능력을 겸비한 인력 양성·공급
	애로수요 해소	· 산업의료원 교과목 매칭을 통한 산업수요 애로 해소(교수, 연구원 등)
	공동기술개발	· 산학 간 인프라(인력, 기술, 장비 등) 공유, 기술지도·자문을 통한 공동연구 지원
산업지원	기술정보	· 산업의 기술 및 구인정보를 대학에 공유 → 수요 맞춤형 프로그램 보급
	강의 지원	· 첨단기술 및 취업마인드 제고 등 강의에 기업인사 참여 → 학생의 취업 마인드 제고
	시설·장비 지원	· 기업 보유장비의 학생 활용기회 제공 → 취업 시 현장에 즉시 투입이 가능한 인재양성
	취업·현장실습 지원	· 학생의 현장실습 기회 제공 → 취업에 대비한 현장 실무능력 배양

반도체 부트캠프사업

[별지 제10호서식] <신설 2023. 10. 4.>

소단위 전공과정 이수 신청서				
1. 인적사항				
학부/전공명	(학년)	학습구분	주간 · 야간	
학 번		성 명		
주 소	(e-mail)			
전화 번호	(휴대전화)			
2. 신청내용				
소단위 전공과정 세부명칭	()마이크로디그리			
학업목표 및 이수계획				
취득학점 현황	이수학기	취득학점		
	총 학기	총 점		
「유연 학사제도 운영 규정」 제30조제2항에 따라 위와 같이 소단위 전공과정 이수를 신청합니다. 년 월 일 신청인 성명 (서명) 한경국립대학교총장 귀하				
구비 서류	신청인 제출서류		학부장 제출 및 담당자 확인	
	신청서 1부		성적증명서 1부	
경 유	원 전공 지도교수	원 전공 학부장	소단위 전공과정 교육운영전공 학부장	
결 재	담당자	팀 장	과 장	처 장

반도체 부트캠프사업

2024학년도 반도체부트캠프 장학생 추천서 (성적 우수자)				
추천자	학 과		학 년	학 번
	성 명		생년월일	년 월 일
	마이크로디그리 이수 여부	중급	연락처(H.P)	
	장학금 지급계좌	은행명 : OO은행 / 예금주 : 000 / 계좌번호 : 00000000000		
○ 제출서류 - 장학생 추천서 - 통장사본 - 2024년도 2학기 장학금 수혜현황 - 성적 증명서 * 2024학년도 2학기 등록금 중 본인이 순수 납부(성적우수 및 국가장학금 등 제외) 한 등록금 중 50만원까지 지급				
위와 같이 000과 000학생이 반도체 부트캠프 000마이크로디그리 과정을 우수한 성적으로 수료하여 2024학년도 한경국립대학교 반도체 부트캠프 장학생으로 추천합니다. 2024년 월 일 신청자 : _____ (인) (추천자) 학과장 : _____ (인)				
한경국립대학교 반도체부트캠프사업단장 귀하				

반도체 부트캠프사업

2024학년도 반도체 부트캠프 장학생 추천서 (생활비성)

학 과			
마이크로디그리명		등급	중급
수강 과목			
추천 인원	00 명		

○ 제출서류

- 장학생 추천서
- [붙임1] 장학생 추천 명단
- 통장사본
- 성적증명서

위와 같이 000과 총 00명의 학생이 반도체 부트캠프 000마이크로디그리 과정을 수료하였기에 2024학년도 한경국립대학교 반도체부트캠프 장학생으로 추천합니다.

2024년 월 일

신청자 : _____ (인)

(추천자) 학과장 : _____ (인)

한경국립대학교 반도체부트캠프사업단장 귀하

반도체 부트캠프사업

[붙임1]

2024학년도 반도체부트캠프 장학생 추천 명단(생활비성)

학과 : 000과

순번	학번	성명	은행	계좌번호	예금주	마이크로디그리 이수 여부
1						중급
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

위와 같이 2024학년도 반도체 부트캠프 사업 장학생을 추천합니다.

2024년 월 일

신청자 : _____ (인)

(추천자) 학과장 : _____ (인)

한경국립대학교 반도체부트캠프사업단장 귀하

8

관련 서류 양식

반도체 부트캠프사업

< ‘장학금 활용계획서’ >

소속학과: 학번: 이름: (인)

예 산 (100만원)	* 장학금을 어떻게 사용하실지에 대한 구체적인 계획을 작성해 주세요.	비고
	<미래 목표>	
	<장학금 활용 계획>	
	<장학금을 받아야 하는 이유>	

반도체 부트캠프사업

<반도체부트캠프 장학금 활용 결과 세부내역서>

소속학과: 학번: 이름: (인)

장학금 (100만원)	활용 금액	활용 내용	비고
	합 계		

질의응답
경청해주셔서
감사합니다.

2024년 한경국립대학교 반도체 인력양성 부트캠프사업 설명회



한경국립대학교
Hankyong National University